

PCB 制程技术参数

电子商务网(开关电源, 电路板, 单片机)

<http://www.sky9218.com> Email: sky9218@163.com

- * 板层: 单面、双面、多层
- * 板厚: 0.2mm - 3.0mm(单、双面板)
0.4mm - 5.0mm(多层板)
- * 最小线宽/线距: 0.1mm(4 mil)/0.1mm(4 mil)
- * 最小孔径: 0.3mm(12 mil); BGA 座部分可加工 0.2mm(8 mil)孔径
- * 孔壁厚度: 大于/等于 0.025mm(1 mil)
- * 金属化孔孔径公差: 小于/等于 0.8mm(32 mil) 孔径为 +/- 0.05mm(2 mil)
大于/等于 0.8mm(32 mil) 孔径为 +/- 0.10mm(4 mil)
- * 镍金厚度: 5um
- * 金厚度: 大于 0.03um
- * 孔径公差: +/- 0.05mm(2 mil)
- * 孔位公差: 小于/等于 0.10mm(4 mil)
- * 外形公差: 0.15mm(6 mil)
- * 基材铜泊厚度: 17.5um(H/HOZ), 35um(1/HOZ), 70um(2/HOZ)
- * 阻焊油: 感光油(SG-5), 热固油(NA401), UV 油, 焗白油(ZM400WF)
- * 阻焊硬度: 大于 5H
- * 热冲击: 288 摄氏度(+5) / 10sec
- * 阻燃性: 94V-0
- * 通断测试电压: 50V - 300V
- * 可焊性: 235 摄氏度(+5)在 3 sec 内湿润
- * 翘曲度: 小于 0.01mm

电子商务网(开关电源, 电路板, 单片机)

<http://www.sky9218.com>
Email: sky9218@163.com